

a-Si : H может быть связано со структурными изменениями аморфной сетки *a*-Si : H, происходящими при введении этой примеси. О возможности таких изменений свидетельствуют увеличение поглощения около 2100 см⁻¹ в ИК спектрах пленок, в которые диспрозий вводился при выращивании (по интенсивности поглощения в этой области обычно судят о степени «микроструктурности» сетки [6]), а также появление широкой полосы поглощения с максимумом около 850 см⁻¹, для выяснения природы которой требуются дальнейшие исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] М. М. Мездрогина, Ф. С. Насрединов, У. С. Турсунов, Р. А. Хайдаров, П. П. Серегин, А. Ф. Бардамид. ФТП, 27, 1123 (1991).
- [2] Физика гидрогенизированного аморфного кремния (под ред. Дж. Джоунопулоса, Дж. Люковски), вып. II. М. (1988).
- [3] W. Beyer, H. Wanger. J. Appl. Phys., 12, 8745 (1982).
- [4] К. Х. Ходжаев. Автореф. канд. дис. Л. (1991).
- [5] А. Р. Регель, У. Ж. Абдуманапов, В. А. Васильев, М. М. Мездрогина, Ф. С. Насрединов, П. П. Серегин. ФТП, 23, 1552 (1989).
- [6] E. Bhattacharya, A. H. Mahan. Appl. Phys. Lett., 52, 1587 (1988).

Редактор В. В. Чалдышев

ФТП, том 27, вып. 8, 1993

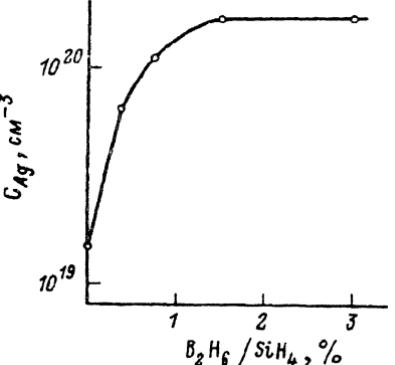
ДИФФУЗИОННОЕ ЛЕГИРОВАНИЕ СЕРЕБРОМ АМОРФНОГО ГИДРИРОВАННОГО КРЕМНИЯ С ПРИМЕСЬЮ БОРА

Г. С. Куликов, М. М. Мездрогина, С. К. Першев

Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021, Санкт-Петербург, Россия
(Получено 21 января 1993 г. Принято к печати 26 марта 1993 г.)

В последние годы наряду с моно- и поликристаллическим кремнием широкое применение в микроэлектронике и солнечной энергетике находит аморфный гидрированный кремний (*a*-Si : H). В приборных структурах легированные фосфором или бором слои *a*-Si : H могут находиться в контакте с металлическими материалами (например, в солнечных элементах, тонкопленочных транзисторах и т. п.), где токоснимающие электроды расположены на *p*- или *n*-слоях *a*-Si : H [1]), и примеси могут диффундировать в такие слои, изменения их электрофизические свойства. Экспериментальные данные, полученные рядом авторов [2-4], свидетельствуют о том, что различные примеси диффундируют в *a*-Si : H значительно быстрее, чем в кристаллический кремний при соответствующих температурах. Это объясняют участием в диффузионных процессах весьма подвижного в *a*-Si : H водорода, а также релаксацией структурной аморфной сетки. В работе [5] было детально изучено влияние диффузионного легирования примесями олова, серебра и железа на электрофизические свойства собственного *a*-Si : H, нелегированного и легированного фосфором в процессе выращивания. Было показано, что диффузия серебра в нелегированные слои *a*-Si : H, обладающие, как правило, проводимостью *n*-типа, приводит к появлению большой энергии активации проводимости E_A^h (до 1 эВ, т. е. $E_A^h > E_g^h/2$). Можно ожидать, что использование серебра в качестве контакта с *p*-слоем приведет к умень-

Рис. 1. Зависимость концентрации продиффундированного в пленку $a\text{-Si : H(B)}$ серебра (400°C , 40 мин) от содержания примеси бора, введенного в пленку при выращивании.



шению высоты барьера между металлическим контактом и легированным слоем. Однако влияние диффузационного проникновения серебра на электропроводность слоев $a\text{-Si : H}$ p -типа не было изучено. В настоящей работе исследованы диффузия серебра и его влияние на электропроводность легированных бором пленок $a\text{-Si : H}$. Пленки были получены методом высокочастотного разложения газовой смеси моносилана с дибораном в многоэлектродной системе. Температура подложки 300°C , скорость роста пленок 1.5 \AA/s [6]. Выращенные на подложках из кварца или монокристаллического кремния пленки имели толщину $0.3\text{--}0.4 \mu\text{m}$.

Ранее было показано [7], что введение диборана в газовую смесь оказывает сильное каталитическое влияние на кинетику роста пленок $a\text{-Si : H}$, а следовательно, и на микроструктуру: скорость роста увеличивается более чем в 2 раза при концентрации $B_2H_6 / (SiH_4 + B_2H_6)$ 0.1%. При этом наблюдается ярко выраженная нетомогенность микроструктуры, меняется тип связей кремния с водородом: увеличиваются концентрации дигидридов и несвязанного водорода.

Диффузия осуществлялась из напыленного на пленку $a\text{-Si : H(B)}$ слоя серебра с примесью радиоактивного изотопа ^{110m}Ag при температуре 400°C в течение 40 мин. После диффузационного отжига слой непротиффундированного серебра удалялся многократным промыванием пленки в смеси $H_2O_2 + HCl$. Усредненная концентрация серебра, продиффундированного в объем пленки, определялась радиометрированием. На рис. 1 представлена зависимость концентрации продиффундированного в пленку серебра от содержания диборана в смеси рабочего газа. Видно, что при изменении содержания B_2H_6 от 0 до 3 об% концентрация диффузционно введенного серебра возрастает от 10^{19} до $1.6 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$. При этом максимальная концентрация серебра достигается уже при содержании B_2H_6 около 1.5 об%. Дальнейшее увеличение содержания диборана, как видно из рис. 1, не приводит к увеличению концентрации серебра, продиффундированного в пленке.

После диффузационного насыщения пленок $a\text{-Si : H(B)}$ серебром нами была исследована их электропроводность (темперальная проводимость) в интервале температур от -50 до 220°C . На рис. 2 представлены температурные зависимости электропроводности пленки исходного аморфного гидрированного кремния, легированного бором при выращивании (3 об% B_2H_6), пленки $a\text{-Si : H(B)}$, диффузионно легированного серебром при температуре 400°C в течение 40 мин ($C_{Ag} = 1.6 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$), и контрольной пленки, отожженной без серебра при тех же условиях (400°C , 40 мин). Отжиг при $T_A = 400^\circ\text{C}$ ($T_A > T_s$) на воздухе приводит, вероятно, к уменьшению гетерогенности микроструктуры вследствие снятия внутренних напряжений, характерных для неупорядоченной структурной сетки $a\text{-Si : H(B)}$.

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что отжиг исходного образца в течение 40 мин приводит к увеличению электропроводности при комнатной температуре примерно на порядок и уменьшению энергии активации проводимости от 0.3 до 0.19 эВ (рис. 2, кривая 3). По нашему мнению, это

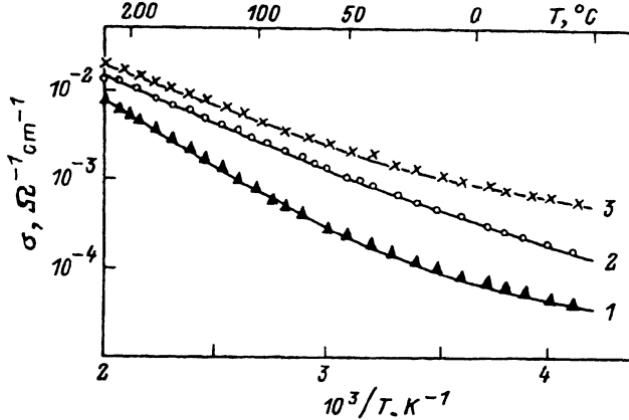


Рис. 2. Температурные зависимости электропроводности пленок $a\text{-Si : H(B)}$. Образцы: 1 — исходная пленка; 2 — контрольный (отожженный при 400°C , 40 мин); 3 — диффузионно легированный серебром (400°C , 40 мин).

обусловлено увеличением эффективности легирования бором в процессе отжига, т. е. увеличением доли четырехкоординированного бора в аморфной гидрированной пленке.

Диффузионное введение серебра (до 10^{20} см^{-3}) приводит к частичной компенсации материала (рис. 2, кривая 2), обусловленной либо проявлением донорных свойств примеси серебра [5], либо возникновением компенсирующих структурных дефектов.

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: концентрация продиффундированного серебра в пленке аморфного гидрированного кремния, легированного бором, возрастает с ростом уровня легирования, т. е. возрастает скорость диффузии серебра; при этом максимальная концентрация серебра, введенного диффузией в пленку при 400°C , составляет $1.6 \cdot 10^{20} \text{ см}^{-3}$; термоотжиг при 400°C пленок, легированных бором (3 об % B_2H_6), приводит к увеличению электропроводности и уменьшению энергии активации проводимости; диффузионное введение серебра в пленку $a\text{-Si : H(B)}$ приводит к компенсации дополнительной проводимости, создаваемой в результате термоотжига; при этом проводимость имеет единую энергию активации (0.2 эВ) в интервале температур 20—220 °C.

Таким образом, как показало настоящее исследование, быстрая диффузия серебра в слои p -типа $a\text{-Si : H(B)}$ и его влияние на электрофизические свойства таких слоев делают нежелательным применение серебра в качестве контакта к слоям с проводимостью p -типа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Аморфные полупроводники и приборы на их основе (под. ред. И. Хамакавы). М. (1986).
- [2] D. E. Carlson. J. Vac. Sci. Techn., 20, 290 (1982).
- [3] D. E. Carlson, C. R. Wronski, J. I. Pankove et al. RCA Rev., 38, 211 (1977).
- [4] H. Matsumura, K. Sakai, M. Maeda, S. Furukawa. J. Appl. Phys., 54, 3106 (1983).
- [5] М. С. Аблюза, Г. С. Куликов, С. К. Першееев, К. Х. Ходжаев. ФТП, 24, 1943 (1990).
- [6] М. М. Мездрагина и др. В кн.: Тез. докл. Всес. сем. «Аморфные гидрированные полупроводники и их применение», 12. Л. (1991).
- [7] J. C. Knights. J. Non-Cryst. Sol., 35/36, 159 (1989).

Редактор В. В. Чалдынцев